

新製品

大気圧 開放 低温施工

## コールド ソフト コート装置



プラスチック、  
フィルム、金属、  
セラミック等の基材に  
銅や各種金属の膜を  
低温でソフトに生成。  
**電気伝導性有(銅膜)**

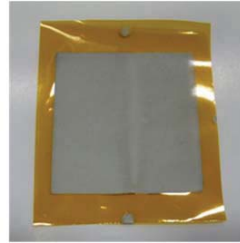
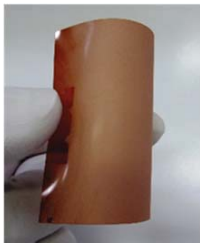
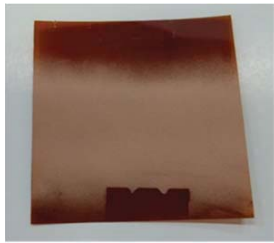
## 特徴

1. 基材への熱影響が少ない(ABS樹脂可)  
(低温施工 約100°C)
2. ソフト基材への施工も可能  
(グラファイト、FRP、樹脂、ガラス等)
3. 高密度皮膜生成
4. 高熱伝導性・高電気伝導性 (銅膜)
5. 低エネルギー消費、低騒音、低粉塵

使用可能粉末 : **Cu、Al、Zn、Sn、Ni** 及び各種混合粉

# コールドソフトコート of 施工例

## ●フィルム、箔等の軟基材への施工例

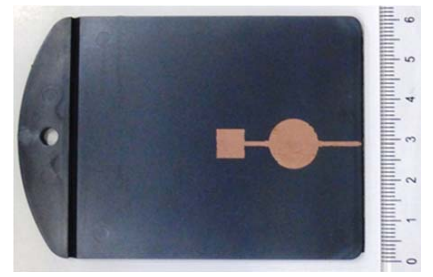
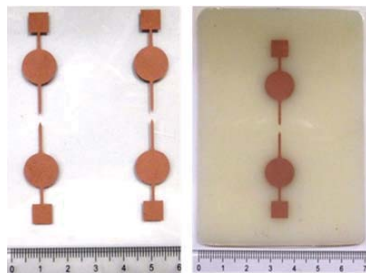
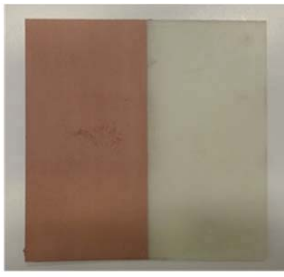


基材:ポリイミドフィルム (Kapton) 125  $\mu$  m  
粉末:銅等、厚さ約 5~20  $\mu$  m

基材:ポリイミドフィルム (Kapton) 25  $\mu$  m  
粉末:銅、錫(Sn)等 厚さ約 5  $\mu$  m

基材:アルミフویل、  
粉末:銅、錫 (Sn) 厚さ10~20  $\mu$  m

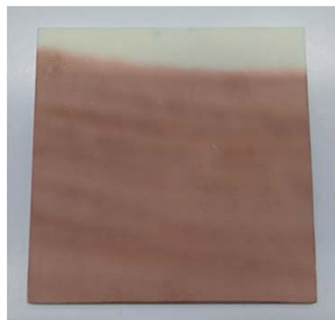
## ●低強度基材への施工例



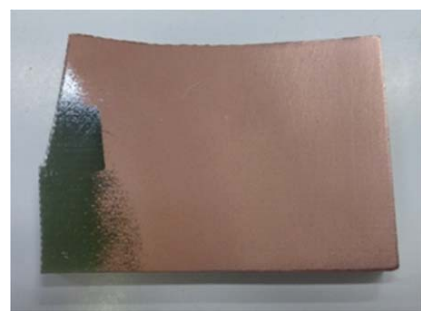
基材:EMS製 高機能 ポリアミド板  
100x100x2t  
粉末:銅、厚さ10~30  $\mu$  m

基材:EMS製 高機能 ポリアミド板  
パターン描写  
粉末:銅 厚さ10~30  $\mu$  m

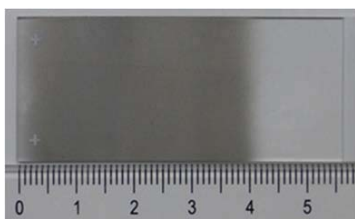
基材:樹脂  
パターン描写  
粉末:銅 厚さ10~20  $\mu$  m



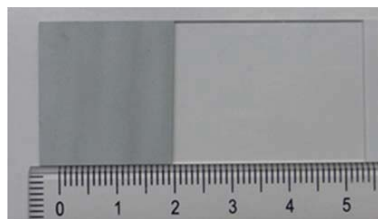
基材:セラミック アルミナ板 100x100x3t  
粉末:銅、アルミ等、厚さ約5~30  $\mu$  m



基材:FRP厚板、粉末:銅  
厚さ10~30  $\mu$  m



基材:ガラス 粉末:ニッケル(Ni)  
厚さ10~30  $\mu$  m



基材:ガラス 粉末:亜鉛 (Zn)  
厚さ10~30  $\mu$  m



基材:ガラス 粉末:錫(Sn)  
厚さ10~30  $\mu$  m